

华创证券有限责任公司
关于气派科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书

保荐机构（主承销商）



贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

二〇二〇年六月

目录

第一节 本次证券发行基本情况	5
一、本次负责推荐的保荐机构	5
二、保荐机构保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况	5
（一）保荐代表人	5
（二）项目协办人	5
（三）其他项目组成员	5
三、本次保荐发行人证券发行的类型	6
四、发行人情况	6
五、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的说明	7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查	7
七、保荐机构内部审核程序和内核意见	8
（一）内部核查程序说明	8
（二）内核意见	9
第二节 保荐机构承诺事项	9
第三节 关于有偿聘请第三方行为的核查意见	10
第四节 对本次证券发行的推荐意见	11
一、对本次证券发行的推荐结论	11
二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查	11
（一）本次发行已履行的决策程序	11
（二）保荐机构核查意见	12
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明	12
（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构	12
（二）发行人具备持续经营能力	12
（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告	13
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪	13
（五）发行人符合中国证监会规定的其他条件	13
四、本次证券发行符合《科创板管理办法》规定的发行条件的说明	13
（一）本次发行申请符合《科创板管理办法》第十条的规定	13

(二) 本次发行申请符合《科创板管理办法》第十一条的规定	14
(三) 本次发行申请符合《科创板管理办法》第十二条的规定	14
(四) 本次发行申请符合《科创板管理办法》第十三条的规定	16
五、本次发行符合《科创属性评价指引(试行)》规定的科创属性的说明	16
(一) 最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上, 或最近三年研发投入金额累计在 6,000 万元以上	16
(二) 形成主营业务收入的发明专利 5 项以上	17
(三) 最近三年营业收入复合增长率达到 20%, 或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	17
第五节 主要风险及发展前景评价	17
一、主要风险因素	17
(一) 技术风险	18
(二) 市场风险	18
(三) 经营风险	19
(四) 与募集资金运用相关的风险	22
(五) 财务风险	23
(六) 公司治理及内部控制风险	25
(七) 发行失败风险	25
(八) 其他风险	25
二、发展前景评价	26
(一) 发行人所处行业前景广阔	26
(二) 发行人的竞争优势	27
(三) 募集资金投资符合行业发展方向及发行人发展目标	30
第六节 保荐意见	30

声 明

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”或“保荐人”）接受气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”、“发行人”）的委托，担任气派科技首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次负责推荐的保荐机构

本次负责推荐的保荐机构为华创证券有限责任公司。

二、保荐机构保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

华创证券有限责任公司授权杨锦雄和孙翊斌为本次发行的保荐代表人，具体负责气派科技本次发行的保荐尽职调查及持续督导等保荐工作事宜。

杨锦雄，保荐代表人，现任华创证券投资银行部董事总经理，具备非执业注册会计师资格。长期从事投行工作，主持过多家IPO企业的改制辅导、发行及上市工作、负责过借壳上市以及上市公司再融资等多项投资银行业务。具备丰富的财务、改制、发行审核等综合实务经验，为不同类型企业提供投行深度价值服务。

孙翊斌，保荐代表人，现任华创证券投行部执行总经理，具备非执业注册会计师、非执业注册税务师资格。长期从事IPO、上市公司审计及投资银行业务，负责或参与过多家IPO企业的改制辅导、再融资、并购重组等投资银行业务。

（二）项目协办人

华创证券指定王江为本次发行的项目协办人。

王江，准保荐代表人，现任华创证券投资银行部副总监，曾参与完成捷捷微电子非公开发行股票等保荐承销项目。

（三）其他项目组成员

彭良松，保荐代表人，现任华创证券投资银行部董事总经理，具有律师、注册会计师资格，曾参与或负责英唐智控、深圳得润电子、三维工程、搜于特、百利科技等IPO项目，中原油气、东方热电、招商证券等再融资项目。

万静雯，现任华创证券投资银行部副总监，金融硕士，非执业注册会计师。

曾参与捷捷微电创业板上市、非公开发行股票等保荐承销项目。

黄永圣千，会计学硕士，现任华创证券投资银行部高级经理，曾参与江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行并上市等保荐承销项目。

陈熠，上海财经大学经济学硕士，现任华创证券投资银行部经理，具有毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所工作经验，具备较强的财务理论及实践经验。

三、本次保荐发行人证券发行的类型

首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市。

四、发行人情况

公司名称	气派科技股份有限公司
英文名称	China Chippacking Technology Co.,Ltd.
注册资本	7,970.00 万元
法定代表人	梁大钟
有限公司成立日期	2006 年 11 月 7 日
股份公司成立日期	2013 年 6 月 6 日
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1#厂房 301-2
主要生产经营地址	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
邮政编码	523330
联系电话	0769-89886666
传真	0769-89886013
电子邮箱	wenzg@chippacking.com
公司网址	http://www.chippacking.com/
负责信息披露和投资者关系的部门	证券法律事务部
信息披露负责人	文正国
信息披露负责人电话	0769-89886666-8501
信息披露人电子邮箱	wenzg@chippacking.com

五、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的说明

截至本发行保荐书签署日，发行人与保荐机构之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形，具体说明如下：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者控制保荐机构或其控股股东、实际控制人股份；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

（四）保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在互相提供担保或融资的情形；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定，本保荐机构将安排依法设立的相关子公司参与本次发行的战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行，本保荐机构及本保荐机构依法设立的其他相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查

保荐机构通过取得并查阅发行人机构股东的工商资料、《公司章程》或《合伙协议》、查询工商信息网站及中国证券投资基金业协会网站等方式，对发行人机构股东是否属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金情况进行了核查，确认公司机构股东中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金及其管理人均已在中国证券投资基金业协会完成备案登记手续。

七、保荐机构内部审核程序和内核意见

(一) 内部核查程序说明

在向上海证券交易所推荐本项目之前，本保荐机构已经通过项目立项审批、问核程序、内核部门审核和内核会议审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查的职责。

1、项目立项审批

项目组通过对项目的初步立项评估，在与客户达成合作意向后，向本保荐机构投资银行部质量控制部（以下简称“投行质控部”）申请立项。投行质控部对立项材料进行初审并出具审核意见，项目组对该审核意见进行书面回复。对于符合立项条件的项目，投行质控部提交立项委员会进行立项审核。

立项会议参加立项审议的委员人数不少于五人（不包括需回避表决但列席会议的立项委员），其中，来自内部控制部门的委员人数不低于参会委员总人数的三分之一。立项会议采取记名投票方式进行表决，同意立项的决议应当至少经三分之二以上的参会委员表决通过。

2020年5月18日，本保荐机构立项委员会对气派科技首次公开发行股票并在科创板上市项目立项进行表决，同意气派科技首次公开发行股票并在科创板上市项目立项。

2、项目问核程序

项目组完成尽职调查阶段的工作底稿并将全套问核申请材料提交所属业务部门负责人审核后，向公司内部控制部门提交问核申请。

公司内部控制部门对全套问核申请材料进行初步审核，由投行质控部组织和实施现场核查工作，并根据实际情况采用单独或联合检查的方式开展现场核查。投行质控部在现场核查过程中对尽职调查阶段的工作底稿进行检查、验收，并出具质量控制报告。

本保荐机构内核管理部组织召开问核会议，问核人对项目尽职调查等执业过程和质量控制等内部控制过程中发现的风险和问题、工作底稿检查和验收情况进

行问核。完成问核的项目，方可启动内核会议审议程序。

2020年6月3日，本保荐机构内核管理部组织召开问核会议，对气派科技首次公开发行股票并在科创板上市项目进行了问核。

3、内核部门审核

项目组将申请内核的全套材料提交所属业务部门负责人审核后，向内核管理部提出内核申请。内核管理部对项目组提交的内核全套材料进行初步审核，并出具内核初审报告，项目组对内核初审报告进行回复。对于符合内核要求的项目，内核管理部提交内核委员会进行内核会议审核。

4、内核会议审核

内核会议须至少有七名内核委员出席方可召开，且来自公司内部控制部门的委员人数不得低于参会内核委员总人数的三分之一，至少有一名合规人员参与投票表决。内核会议采取记名投票方式，经三分之二以上参会委员投“内核通过”的，视为内核通过。

(二) 内核意见

2020年6月5日，本保荐机构召开内核会议，各参会内核委员对发行人首次公开发行股票并在科创板上市进行了审核，表决结果为“内核通过”。通过履行以上内核程序，本保荐机构认为发行人本次发行申请符合《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的各项条件，同意向上海证券交易所推荐。

第二节 保荐机构承诺事项

本保荐机构承诺，已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》第29条的规定，遵循行业公认的勤勉尽责精神和业务标准，履行了充分的尽职调查程序，并对申请文件进行审慎核查后，作出如下承诺：

一、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

二、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

三、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

四、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

五、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

六、保证本发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

七、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

八、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

九、本保荐机构为发行人本次申请首次公开发行并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失；

十、中国证监会、上海证券交易所规定的其他事项。

第三节 关于有偿聘请第三方行为的核查意见

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告2018]22号）的规定，本保荐机构就气派科技首次公开发行股票并在科创板上市项目在业务执行中是否存在有偿聘请各类第三方机构和

个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行了核查。

截至本发行保荐书签署日，华创证券作为气派科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

经核查，发行人除依法聘请了证券服务机构外，还有偿聘请了北京和勤天成管理咨询有限公司为本次募集资金投资项目出具可行性研究报告。除上述聘请行为外，气派科技首次公开发行股票不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方为公司首次公开发行并在科创板上市提供服务的行为。

第四节 对本次证券发行的推荐意见

一、对本次证券发行的推荐结论

华创证券作为气派科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照《公司法》《证券法》《科创板首发管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，对发行人进行了审慎的核查，并与发行人、发行人律师及发行人审计机构充分沟通，认为气派科技具备首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，本保荐机构同意担任气派科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，并承担相关的保荐责任。

二、对发行人本次发行是否履行决策程序的核查

（一）本次发行已履行的决策程序

发行人就首次公开发行股票并在科创板上市事宜履行的内部决策程序如下：

1、董事会

2020年4月30日，发行人第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于制定〈公司章程（草案）〉及其附

件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》等与本次发行及上市相关的各项议案。

2、股东大会

2020年5月22日，发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等与本次发行及上市相关的各项议案。

(二) 保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：发行人上述董事会、股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》等的规定，并已依法定程序作出决议，上述决议的内容合法、有效；气派科技申请首次公开发行股票并在科创板上市已履行了必要的内部决策程序。

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明

本保荐机构按照中国证监会及上交所的有关规定进行了充分的尽职调查和审慎核查，确认发行人符合《证券法》规定的发行条件：

(一) 发行人具备健全且运行良好的组织机构

本保荐机构查阅了发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》、历次股东大会、董事会、监事会决议、会议记录及相关制度文件，实地考察了发行人各部门的经营运作，确认发行人已具有完善的公司治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会各专门委员会等制度，建立健全了内部经营管理机构，相关机构和人员能够依法履行职责，公司治理规范有效，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项之规定。

(二) 发行人具备持续经营能力

本保荐机构核查了会计师事务所出具的发行人最近三年的审计报告等财务资料、发行人主营业务最近三年的经营情况、发行人正在履行的重大业务合同等

资料，发行人财务状况良好，具备持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人首次公开发行股票并在科创板上市出具了无保留意见的《气派科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2020]28117号），符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

本保荐机构对相关政府部门进行了访谈，查阅了公安机关、检察院、法院等政府机构的网络公开信息，取得了相关政府部门出具的守法证明，确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

（五）发行人符合中国证监会规定的其他条件

经核查，本保荐机构认为发行人符合中国证监会对股份公司首次公开发行股票并上市所规定的其他资格条件，发行人符合《证券法》第十二条第一款第（五）项之规定。

四、本次证券发行符合《科创板管理办法》规定的发行条件的说明

本保荐机构按照中国证监会颁布的《科创板管理办法》的相关规定，对发行人是否符合首次公开发行股票并在科创板上市条件进行了逐项核查，核查情况如下：

（一）本次发行申请符合《科创板管理办法》第十条的规定

本保荐机构查验了发行人的工商登记资料、创立大会议案和决议，确认发行人成立于2006年11月7日，于2013年6月6日依法按照账面净资产值整体变更为股

份有限公司并取得统一社会信用代码为914403007954196722的企业法人营业执照，截至目前仍依法存续。

本保荐机构查验了发行人的公司章程，股东大会、董事会、监事会会议文件和内部制度文件，确认发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

经核查，本保荐机构认为发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，发行人符合《科创板注册管理办法》第十条的规定。

（二）本次发行申请符合《科创板管理办法》第十一条的规定

本保荐机构查验了发行人财务制度、核算体系、账务明细及凭证以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《气派科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2020]28117号），确认发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

本保荐机构查验了发行人的内部控制制度、关于内部控制的自我评估报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》（天职业字[2020]28961号）并与会计师的沟通，确认发行人按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创板注册管理办法》第十一条的规定。

（三）本次发行申请符合《科创板管理办法》第十二条的规定

本保荐机构查验了发行人股东大会、董事会、监事会会议文件、业务流程、内部制度、组织机构和职能部门设置情况、并同发行人各部门负责人进行访谈，确认发行人已建立适合自身发展的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。具体情况如下：

1、本保荐机构查验了发行人资产权属证书、审计及财务报告、控股股东及实际控制人控制企业的企业法人营业执照、工商登记资料、财务报告、银行账户流水等资料，根据发行人相关陈述、并同发行人高级管理人员进行访谈，确认发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创板注册管理办法》第十二条第(一)款的规定。

2、本保荐机构查验了发行人企业法人营业执照、公司章程、股东大会、董事会、监事会会议文件、工商资料、财务报告、产品销售合同、控股股东及相关公司的工商资料等，确认发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人控股股东为梁大钟，实际控制人为梁大钟和白瑛，梁大钟和白瑛分别持有公司64.18%、13.55%的股份，同时梁大钟通过气派谋远间接控制公司0.02%的股份，梁大钟、白瑛合计控制公司77.75%的股份，股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创板注册管理办法》第十二条第(二)款的规定。

3、本保荐机构查验了发行人的机器设备台账、土地使用权证书、商标证书、专利证书、计算机软件著作权证书、根据发行人陈述，确认发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。经查验发行人的公司章程、股东大会、董事会和监事会会议文件、审计报告、财务报告、银行账户流水、中国人民银行征信中心出具的企业信用报告、全国法院被执行人信息公开网，并根据发行人陈述，确认发行人不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。经查验发行人所属行业的行业研究报告、行业规划、相关产业政策、同行业上市公司财务报告和研究报告，并经走访发行人客户和供应商，确认发行人不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化，不存在对持续经营有重大不利影响的事项。

经核查,本保荐机构认为发行人符合《科创板注册管理办法》第十二条第(三)款的规定。

(四) 本次发行申请符合《科创板管理办法》第十三条的规定

本保荐机构查验了发行人企业法人营业执照、公司章程、产品销售合同、国家发展和改革委员会等政府部门颁布的产业政策文件、发行人所在地各主管政府部门出具的证明文件,发行人主要从事集成电路封装、测试机提供封装技术解决方案,不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》所规定的限制类、淘汰类业务,发行人的经营符合法律、行政法规的规定,符合国家产业政策。

本保荐机构查验了发行人所在地各主管政府部门出具的证明文件、实际控制人梁大钟白璞户籍(或居住)所在地派出所出具的守法证明、全国法院被执行人信息公开网、中国证监会行政处罚公开信息,确认发行人及其实际控制人最近3年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

本保荐机构查验了发行人董事、监事和高级管理人员户籍(或居住)所在地派出所或公证处出具的无违法犯罪记录证明、中国证监会行政处罚公开信息、根据发行人董事、监事和高级管理人员的陈述,确认发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见等情形。

经核查,本保荐认为发行人符合《科创板管理办法》第十三条的规定。

五、本次发行符合《科创属性评价指引(试行)》规定的科创属性的说明

本保荐机构依据《科创属性评价指引(试行)》对发行人是否符合科创属性评价指引相关条件进行了逐项核查,相关情况如下:

(一) 最近三年研发投入占营业收入比例5%以上,或最近三年研发投入金

额累计在6,000万元以上

本保荐机构查验了天职国际会计师事务所出具的《气派科技股份有限公司审计报告》（天职业字[2020]28117号）及发行人财务报表、研发项目核算等财务资料。报告期内，发行人研发投入分别为1,853.85万元、2,187.53万元、2,752.15万元，报告期内各年研发投入占当期营业收入的比例分别为4.64%、5.77%、6.64%；报告期内发行人研发投入累计6,793.52万元，占报告期内累计营业收入的比例为5.70%。

经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创属性评价指引（试行）》关于“最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在6,000万元以上”的规定。

（二）形成主营业务收入的发明专利5项以上

本保荐机构查验了国家知识产权局出具的《证明》、专利代理机构出具的《确认函》、发明专利权属证书、主营业务收入构成等相关资料。报告期内，发行人形成主营业务收入的发明专利为8项。

经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创属性评价指引（试行）》关于“形成主营业务收入的发明专利5项以上”的规定。

（三）最近三年营业收入复合增长率达到20%，或最近一年营业收入金额达到3亿元

本保荐机构查验了发行人审计报告、财务报告等相关资料。报告期内，发行人营业收入复合增长率为1.89%，最近一年营业收入为41,446.86亿元。

经核查，本保荐机构认为发行人符合《科创属性评价指引（试行）》关于“最近三年营业收入复合增长率达到20%，或最近一年营业收入金额达到3亿元”的规定。

第五节 主要风险及发展前景评价

一、主要风险因素

（一）技术风险

1、新产品和新技术开发风险

公司所处的集成电路封装测试行业具有封装技术多样、技术及产品更新速度快的特点。如果公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断，快速识别并响应客户需求的变化，在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入，或者正在研发的新产品不能满足客户需要，或者公司的技术与工艺水平无法跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，公司将难以巩固和维持自身的竞争优势和市场地位，也无法开拓新的业务市场，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

2、研发技术人员流失和核心技术失密风险

公司自成立以来一直从事集成电路封装测试业务，所处行业为资金、资产、技术、管理和人才密集型行业，优秀的研发技术人员是公司赖以生存和发展的重要基础，是公司获得和保持持续竞争优势的关键。随着集成电路封装测试市场竞争的不断加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇、设立具备较强吸引力的激励考核机制，公司将难以持续引进并留住优秀研发技术人员，公司将可能面临研发技术人员流失的风险；如果出现技术人员流失，公司还将面临技术泄密的风险。

（二）市场风险

1、市场竞争加剧风险

随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等行业领域的快速发展及物联网、智能装备制造等新兴领域的兴起，国内集成电路封装测试需求持续稳定增长，同时中央和地方政府也加大了半导体行业的产业扶持力度，集成电路封装测试行业对资金和资源的吸引力进一步增强，使得市场竞争愈发激烈。一方面，长电科技、通富微电、华天科技等内资企业不仅通过资本市场募集资金增加生产线、进行技术和产品的升级改造以提升产品产能、质量和技术水平，还通过收购兼并的方式实现了产能的大幅提升和技术的升级迭代。另一方面，外资和合资封装测试企业进一步布局中国大陆，加大了资金和资源的投入。因此，公司部分产品不仅面临国内、国际同行业企业的激烈竞争，还面临行业潜在或新进入者的竞争威胁。

如果公司不能通过持续的技术升级和加强质量控制以提升产品性能、降低成本、加大市场拓展力度等手段及时应对市场变化，将可能导致公司产品市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、行业波动及需求变化风险

公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，半导体行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。半导体行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球半导体产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

同时，公司下游消费电子行业产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多等特点，消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化速度快，不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期短于其他传统行业。如果公司未来不能快速响应终端市场的需求变化，或公司主要客户对应产品在终端市场竞争中处于不利地位，公司现有市场规模将难以保持甚至出现萎缩，进而对公司经营业绩造成不利影响。

（三）经营风险

1、生产效率下降风险

集成电路封装测试行业的生产模式最主要的特征是多批次、多品种，如何通过合理、有效的管理和组织调度，生产出符合客户要求的产品，同时满足客户快速交货的需求是企业核心竞争力的重要体现。

随着公司生产规模的不断扩大、工艺流程的日益复杂，如果公司未来不能在管理方式上及时创新，生产人员技术水平及熟练程度无法保持或者持续提升，公司将会面临生产效率下降的风险。生产效率下滑将导致公司生产规模无法保持或持续扩大，不仅会使产品交期延长、竞争力削弱及客户流失，同时还会使公司无法保持在成本控制方面的优势，将会对公司经营业绩产生不利影响。

2、销售区域集中风险

报告期内，公司业务主要集中在华南地区，2017年至2019年，公司来自于华

南地区的主营业务收入占比分别为58.85%、62.59%和59.51%。公司业务集中在华南地区的主要原因为以深圳为核心的珠三角地区是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，集成电路设计公司将封装和销售环节放在深圳，通过销售环节的快速反应能力，能够更紧密的与客户联系。如果华南地区的销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。

3、业绩及毛利率波动风险

公司主要从事集成电路封装测试业务，经营业绩会随着终端产品市场的波动而变化；同时，集成电路封装测试行业竞争激烈，价格相对透明，相应的封装测试企业整体毛利率水平不高，2017年至2019年，公司主营业务毛利率分别为24.80%、18.93%、20.75%。

未来若终端产品市场出现较大波动，或者公司不能通过持续的研发投入不断提升生产技术水平、强化成本控制以保持成本优势，或者随着市场竞争的加剧、竞争者的数量增多及技术服务的升级导致公司调整产品及服务的定位、降低产品及服务的价格，公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

4、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括引线框架、塑封树脂、丝材（金丝、银线、铜线、合金线）和装片胶。2017年至2019年，公司主营业务成本中原材料占比分别为41.63%、37.25%、37.34%，占比较高。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

5、生产用工短缺及劳动力成本上升风险

公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，属于资金、资产、管理、技术及人才密集型企业，其中，充足的生产人员尤其是熟练工人是公司正常经营和快速发展的必要条件。公司未来如果不能保持或及时招聘到足够的技术工人，将会对公司的生产效率产生不利影响，从而影响公司的盈利能力。此外，近年来我国劳动力成本持续上升，国家统计局资料显示，2017年至2019年，全国制造业在

岗职工平均工资增长幅度保持在10%以上，2018年、2019年公司职工薪酬上升幅度分别为17.41%、8.01%，持续上涨的劳动力成本将给公司的盈利能力造成一定的不利影响。

6、汇率波动风险

报告期内，公司出口销售收入分别为 379.95 万元、146.92 万元、513.40 万元，出口收入占同期营业收入的比例较小。

同时，公司生产经营所需机器设备 70%以上为进口设备。报告期内，公司未直接进口生产设备，主要通过先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司等采购专业设备。公司本次募集资金投资项目需进口设备 31,564.18 万元(含税)。公司与先域微电子技术服务（上海）有限公司深圳分公司已经建立了稳定的合作关系并通常约定以人民币计价结算，但如未来人民币汇率波动加剧，公司进口设备结算价格也将受到影响，因而公司存在一定的汇率波动风险。

7、季节性风险

报告期内，公司一季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为 18.91%、21.14%、20.09%。公司封装测试产品主要用于移动电源、开关电源、通讯设备、家用电器、5G基站、医疗器械等领域。由于行业和终端用户特性，同时受芯片及终端产品生产周期的影响，每年的第四季度和次年的第一季度属于该等终端消费品的需求旺季，但由于次年的第一季度包含春节假期，节假日较长，公司客户及终端用户会提前在第四季度备货，相应的每年的第一季度为公司的业务淡季。若未来公司客户及终端用户的采购需求仍具有季节性，将对公司的生产经营产生一定的影响，公司的经营业绩将出现季节性波动。

8、新型冠状病毒肺炎疫情风险

公司主营业务为集成电路封装测试，公司封装测试产品主要应用于移动电源、开关电源、通讯设备、家用电器、5G基站、医疗器械等领域。截至本发行保荐书签署日，新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营活动暂未构成重大不利影响。如后续新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内蔓延且持续时间过长，本公司及本公司的供应商、客户的生产经营、业务拓展、销售回款等可能受到一定的不利

影响，同时公司封装测试产品的终端应用领域需求也可能出现萎缩，从而对公司经营业绩产生不利影响。

9、房屋及土地已抵押的风险

广东气派将其拥有的东府国用（2014）第特112号国有土地使用权66,670.10平方米及其上的全部房产（粤（2017）东莞不动产权第0119369号、粤（2017）东莞不动产权第0119366号等8项，合计建筑面积96,482.13平方米）抵押给中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行，综合授信期间为2018年9月1日至2021年8月31日。截至2020年3月31日，广东气派前述不动产抵押的综合授信额度为14,000万元，该综合授信额度实际贷款金额4,000万元、开具银行承兑汇票3,379.69万元。如果未来公司生产经营出现重大不利变化导致资金链断裂而造成贷款违约，公司将面临被债权人主张担保债权而导致该土地使用权及房产被折价抵偿或拍卖、变卖的风险。

（四）与募集资金运用相关的风险

1、募集资金投资项目新增产能消化风险

本次募集资金将用于高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目和研发中心（扩建）建设项目，该等项目已经取得相应政府部门的项目备案，符合目前国家的产业政策和市场需求。公司对上述项目的可行性进行了充分的论证，认为募集资金投资项目将进一步提升公司的核心竞争力、完善公司产品结构、保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。

本次募集资金投资项目达产后将新增产能 16.1 亿只/年，其中 QFN/DFN、CDFN/CQFN、Flip Chip 新增产能分别为 10 亿只、2.2 亿只、2.4 亿只。由于募集资金投资项目达产后 QFN/DFN、CDFN/CQFN、Flip Chip 产能新增或扩充十分明显，但是产品的市场需求、生产成本、销售价格等都有可能与公司的预期产生差异。如新项目出现未能预料的运营问题、项目建设过程中管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情况发生，将可能影响募集资金投资项目的实施和盈利能力。

2、募集资金投资项目进口设备受限的风险

公司本次募集资金投资项目将向日本东京精密株式会社、ASM、日本东和株式会社等国外知名集成电路设备生产商采购设备31,564.18万元（含税），其中暂无国产替代的进口设备26,555.62万元（含税）、已有国产替代的进口设备5,008.56万元（含税）。公司募集资金投资项目所需进口设备目前未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备及其生产技术的出口管制力度，如本公司募集资金投资项目所需进口设备被限制出口或受管制，则将对本公司募集资金投资项目的顺利实施带来不利影响，从而影响公司发展战略及发展目标实现，将对公司经营业绩造成较大不利影响。

3、募集资金投资项目导致经营业绩下滑风险

根据募集资金使用计划，本次募集资金投资项目预计新增固定资产40,168.68万元、无形资产713.48万元，募集资金投资项目达产后年资产折旧和摊销费用将增加3,924.31万元。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销，将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率水平。

（五）财务风险

1、应收账款回收风险

公司报告期各期末应收账款净额分别为 6,297.45 万元、7,081.87 万元、7,582.41 万元，占当期流动资产的比例分别为 24.93%、32.34%、25.10%，占比较高。报告期内，公司应收账款账龄不长，账龄 1 年以内应收账款占应收账款余额的比例均在 95% 以上；公司建立了相应的应收账款管理制度加强应收账款的回收管理，应收账款实际发生坏账的风险较小。

未来随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、存货跌价风险

公司报告期各期末存货净额分别为3,648.34万元、5,292.76万元、5,714.66万元，占当期流动资产的比例分别为14.44%、24.17%、18.92%，存货占流动资产

的比例较高。尽管公司的生产模式主要为以销定产的定制化生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织生产；但公司报告期末存货余额较大，若下游客户存在重大延期或违约，公司将承担存货跌价的风险。

3、税收政策变化及政府补助减少风险

(1) 企业所得税

公司及全资子公司广东气派均为高新技术企业，2017年度、2018年度、2019年度企业所得税率均为15%，上述各期所得税优惠金额分别为450.59万元、157.59万元、396.93万元，占当期利润总额的比例分别为8.34%、9.26%、10.51%。

根据《企业所得税法》及《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《财政部 国家税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）等文件的规定，2017年度、2018年度、2019年度发行人发生的符合条件的研究开发费用分别按照实际发生额的50%、75%、75%加计扣除，2017年度、2018年度、2019年度研发费用加计扣除按照适用税率计算的优惠金额分别为100.08万元、208.99万元、245.19万元，占当期利润总额的比例分别为1.85%、12.28%、6.49%。

报告期内，公司享受的企业所得税优惠政策在一定程度上提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生变化，对集成电路封装测试行业及公司的政策支持减少，将对公司的经营业绩造成不利影响。

(2) 政府补助

报告期内，公司实际收到政府补助827.71万元、710.70万元、2,225.18万元。报告期内，公司计入损益的政府补助分别为481.71万元、559.48万元、448.41万元，占当期利润总额的比例分别为8.92%、32.87%、11.87%。

公司享受的上述政府补助主要为政府部门给予的科技专项资金、产业技术与开发资金、产业化资金，均取得了有关部门的批准，合法合规。报告期内，公司享受的政府补助在一定程度上提升了公司经营业绩，若未来公司取得的政府补助大幅减少，会对公司的经营业绩造成不利影响。

（六）公司治理及内部控制风险

1、实际控制人不当控制风险

本次发行前，梁大钟、白瑛夫妇合计直接持有公司77.73%的股份，梁大钟通过气派谋远间接控制公司0.02%的股份；同时梁大钟担任公司董事长、总经理，白瑛担任公司董事；梁大钟、白瑛夫妇为公司的实际控制人。本次发行完成后，梁大钟、白瑛仍将持有本公司58.29%的股份，梁大钟通过气派谋远间接控制公司0.01%的股份（假设公司公开发行新股2,657万股，且未进行老股转让），梁大钟、白瑛仍将为公司实际控制人。未来梁大钟、白瑛若不能很好的约束自身行为，通过在股东大会上行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等重大事项予以不当控制，将可能对公司发展产生不利影响、损害公司及其他股东的利益。

2、规模扩张带来的经营管理风险

公司通过多年的持续发展，已建立起与公司业务相匹配的经营管理体系。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、业务结构、组织机构和人员将进一步扩充，公司将面临内部控制、生产与质量管理、市场开拓、财务管理等方面的挑战。如果公司不能顺应上市后的发展，及时调整、完善组织结构和管理体系以适应公司的快速扩张，公司将存在一定的经营管理风险。

（七）发行失败风险

公司本次拟申请公开发行股票并在科创板上市，如公司的投资价值未能获得投资者的充分认可，公司预计发行后总市值不满足明确选择的市值与财务指标上市标准，或者网下投资者申购数量低于网下初始发行量，根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的规定，应当中止发行。因而，公司存在发行认购不足、发行定价过低导致未能达到预计市值上市条件等发行失败的风险。

（八）其他风险

1、盈利被摊薄风险

气派科技2019年度以归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益

为0.42元、加权平均净资产收益率为7.38%。本次发行后，公司股本总额、净资产将大幅增加，但由于募集资金投资项目建设、产能释放和消化需要时间，在短期内不能立即产生经济效益；因此，公司发行完成后的每股收益及净资产收益率可能会出现下降，从而导致公司即期回报被摊薄。

2、股价波动风险

公司将以股东利益最大化为最终目标，加强内部管理，强化成本管控，积极拓展国内外市场，提升公司盈利能力；同时，公司将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的规章、规则的要求规范运作，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。但是，股票二级市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩和未来前景，还受国家政策、宏观经济周期、资金供求关系等诸多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动，因而公司股票价格存在波动的风险。

二、发展前景评价

发行人具有较强的自主创新能力和持续盈利能力，根据发行人所处集成电路行业及产品应用领域的行业发展前景，结合发行人目前的竞争优势和未来发展战略及其具体实施计划判断，发行人具备持续经营的能力，未来发展前景良好。

（一）发行人所处行业前景广阔

1、集成电路产业是国家重点发展领域

半导体集成电路产业作为国防安全和经济发展的支柱产业，是国民经济转型的重要一环，国家给予了高度重视和大力支持，为国内集成电路行业的发展提供了良好的政策环境，并将在较长时期内给行业发展带来强有力的推动作用。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》《信息产业发展指南》等文件的发布以及国家集成电路产业投资基金（一期和二期）的设立，我国半导体集成电路产业的发展步入了新的快车道。

通过近些年来的快速发展，我国已经成为集成电路封装测试产业链的重要一极，长电科技、通富微电、华天科技等企业的封装测试产能产量已经进入全球前十；与之对应的是，在Flip Chip、BGA、CSP、WLCSP、MCM、SiP、TSV以及

第三代半导体封装等先进封装技术应用方面，国内企业与国外领先企业仍存在一定的差距，日月光、安靠等国外领先企业在高端产品应用领域中仍占据主导地位，我国集成电路封装测试产业整体竞争力一般。因此，近年来我国不断推出相关政策并提供资金推动集成电路产业的发展，鼓励和支持国内企业在集成电路先进封装技术领域实现质的突破。

2、市场空间巨大，行业发展前景广阔

我国是目前全球最大的集成电路消费市场，中国市场对集成电路产品的需求增速远高于全球平均水平，2018年需求规模增至16,031.8亿元，同比增长12.5%。2019年中国集成电路产业销售额达到7,562.3亿元，同比增长15.8%，根据中国半导体行业协会（CSIA）预测，中国集成电路产业未来几年将继续保持15%以上增长率增长。同时，随着5G商用的加速推进，云计算、大数据、物联网等产业的逐步成熟，将带动半导体集成电路封装测试需求的快速增长。

（二）发行人的竞争优势

1、技术研发优势

集成电路封装测试属于技术密集型行业，行业创新主要体现为生产工艺的创新，技术水平主要体现为产品封装加工的工艺水平。气派科技通过近十五年的技术研发积累与沉淀，现已形成了5G MIMO基站 GaN微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、产品性能提升设计技术、精益生产线优化设计技术等核心技术，推出了自主定义的CPC和 Qipai封装系列产品，对贴片系列产品予以了优化升级等，并已申请了发明专利。

2014年11月，公司自主定义的Qipai8封装产品经深圳市企业创新纪录审定委员会审定为“第一款由中国人发明的封装形式”，纪录水平已达到“国内同行首创”。公司全资子公司广东气派于2017年9月通过广东省科学技术厅“广东省气派集成电路封装测试工程技术研究中心”认定。2019年12月，公司自主定义的“CPC封装技术产品”被广东省高新技术企业协会认定为2019年度广东省高新技术产品。2020年4月，广东气派通过东莞市科学技术局“东莞市集成电路封装测试工程技术研究中心”认定。公司自身的技术研发实力不断提升，已具备

封装测试领域的技术研发优势，研发优势不断转化为研发成果，未来将进一步提升现有核心业务的技术水平，开发出更具竞争力的封装测试产品，巩固和扩大自身的竞争优势。

2、人才优势

气派科技的多数高级管理人员及部分核心技术人员拥有 15 年以上集成电路技术研发或管理经验，具备国际领先企业的行业视野或国内一流企业的从业经验，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力、设计新产品、开发新工艺提供强有力的人力资源支持。截至 2019 年末，公司拥有研发技术人员 154 人，占员工总人数的 15.13%。

公司不仅在研发人员及管理团队中具备人才优势，也将人才优势进一步推广到生产一线，为近年来公司精益生产线优化设计技术的深层次应用奠定了人力资源基础。公司组织了后备经理人培训、一线主管技能培训班组长培训，不断完善产线员工技能培训体系，培训项目“集成电路封装工”和“集成电路测试工”获得“一镇一品特色培训项目”称号。

同时，为充分利用高校学科及人力资源优势，公司积极推进“产学研”合作，以广东气派为例，已开展了如下工作：

A、与广东科技学院深入合作，成为东莞市第一批产教融合型企业；同时，目前正与东莞职业技术学院联合进行职业工种开发；

B、与东莞技师学院、惠州技师学院开展“订单式”人才培养，各设有一个“气派班”，第一批“气派班”学生将毕业进入公司；

C、与中南大学、广东科技学院、广东技师学院、惠州技师学院、广西河池学院合作共建“产学研基地”、“教学实践基地”或“实习基地”。

3、生产组织与质量管理优势

集成电路封装涉及的产品种类繁多，目前公司的主要封装产品包括 Qipai、CPC、SOP、SOT、QFN/DFN、LQFP、DIP 等七大系列，共计超过 120 个品种。相对齐全的产品线为公司满足客户多元化的产品需求和建立市场优势发挥了重

要作用。但同时，不同的产品类型往往需要不同生产工艺、生产设备、供应商体系、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。

公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，培养了超过 150 名经验丰富的研发技术人员和一大批生产管理人才。基于丰富的生产经验和成熟的技术工艺，公司采用柔性化的生产模式，能根据客户的订单要求，灵活地分配生产计划和产品组合，迅速地调试和组合生产线，实现高效率、多批次、小批量的生产，有效地增强了市场反应能力。公司建立了严格的质量管理体系，完善了工作规范和质量、工艺控制制度，并通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系与 ISO14001:2015 环境管理体系认证。

4、地域优势

公司客户主要为集成电路芯片设计企业，其对交货时间要求严格，交货时间短和便利的地理位置可为集成电路芯片设计企业减少库存，节约运输时间和资金成本，及时应对来自客户的随机性和突发性需求，方便企业与客户的交流和反馈，增强其竞争力。

2018年中国IC设计主要区域销售额

地区	销售额（亿元）	同比增长	占比
长江三角洲	821.0	12.6%	32.6%
珠江三角洲	804.2	27.8%	31.9%
京津环渤海	588.6	37.2%	23.4%

数据来源：《中国半导体封装测试行业调研报告（2019年版）》

从区域分布来看，以深圳为核心的珠三角地区是中国电子产品制造基地和进出口集散地，具有贴近市场的地域优势，随着珠三角地区集成电路发展潜力的逐步释放，产业配套的逐步完善，近年来珠三角地区的集成电路设计业发展迅速，在国内集成电路产业中所占比重也逐年提升，区域的发展优势进一步突显。

以深圳为例，在2018年统计的全国十大集成电路设计企业中，深圳占据了3家。据深圳市半导体行业协会统计，2018年深圳集成电路行业实现销售收入897.94亿元，其中IC设计业销售额为758.7亿元，增速达到32.42%。同时，深圳IC设计业销售额在中国大陆城市中排名第一，也是唯一一个超过100亿美金销售额

的城市。

气派科技地处深圳，电子元器件配套市场的迅速崛起以及半导体设计行业的蓬勃发展为气派科技提供了快速发展的沃土。公司充分发挥地域优势进行客户开拓，通过上门接送货物等服务方式节约运输时间、缩短交货期和降低物流成本，加深与客户的交流，销售服务利于得到客户认可，提高公司市场占有率。

5、规模优势

芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。为构建公司在国内封装测试行业的规模优势，公司在东莞投资完成了自有厂房的建设，为持续的产能的扩充以及技术改造提供了物理条件。

公司现已发展成为华南地区规模最大的内资封装测试企业之一，2019 年公司集成电路封装销量达到 62.58 亿只，已形成了自身的规模优势。同时，公司仍在进行持续的资本性支出，不仅提升了公司技术层级，丰富了产品类别，优化了客户结构，还使得公司产能和销售规模也得到进一步提升，继续利用规模优势来巩固和提高公司在行业内的竞争地位。

（三）募集资金投资符合行业发展方向及发行人发展目标

发行人本次募集资金投资项目紧紧围绕集成电路封装测试主营业务，着重提高主营业务的生产能力和研发能力，随着募集资金投资项目的实施和达到销售目标，公司盈利能力将有较大提高。

第六节 保荐意见

本保荐机构在进行充分尽职调查、审慎核查的基础上认为：发行人符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的各项条件。发行人本次公开发行股票有利于全面提升公司的核心竞争力，募集资金投资项目符合国家产业政策要求，项目实施后有助于提升公司的盈利能力。

因此,本保荐机构同意保荐气派科技股份有限公司本次首次公开发行股票并在科创板上市。

附件:保荐代表人专项授权书

(以下无正文)

(此页无正文,为《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签署页)

保荐机构法定代表人、董事长: 陶永泽
陶永泽

保荐机构总经理: 陈强
陈强

保荐业务负责人: 叶海钢
叶海钢

内核负责人: 高瑾妮
高瑾妮

保荐代表人: 杨锦雄
杨锦雄

孙翊斌
孙翊斌

项目协办人: 王江
王江



（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签署页）

保荐业务部门负责人：



叶海钢



华创证券有限责任公司

2020年6月22日

华创证券有限责任公司保荐代表人专项授权书

上海证券交易所：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司授权杨锦雄和孙翊斌两位同志担任气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人，负责该公司发行上市的保荐及持续督导等工作事宜。

特此授权。

保荐代表人签字： 杨锦雄
杨锦雄

孙翊斌
孙翊斌

法定代表人或授权代表签字： 陶永泽
陶永泽

